



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

射频接口: **纳米微型**

射频连接器种类: **插头**

阻抗: **50 Ω**

与射频电缆类型兼容: **RG 178**

射频连接器耦合机制: **螺丝**

产品特性

产品类型特性

射频接口	纳米微型
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 178
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	8
PCB 安装方向	水平
同轴端子数	8

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直角
主体材料	铝
主体电镀材料	无电镀镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----



PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

射频连接器耦合机制	螺丝
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	焊接

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	60 – 1 GHz
------	------------

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



客户还购买了



TE 产品编号747375-2
37 PLUG SP/FMS STD



TE 产品编号1-87227-4
28 MODII HDR DRST UNSHRD .100



TE 产品编号103635-6
07 MTE HDR SRRA LATCH .100CL



TE 产品编号2-1437571-7
TPA11CGPC2=SWITCH P/B N/O REDP

文档

数据表/目录页

Nanonics Connectors for MIL-DTL-32139

英文版本